(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2007 年1 月18 日 (18.01.2007)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2007/007531 A1

(51) 国際特許分類:
H01L 21/683 (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2006/312685

(22) 国際出願日: 2006 年6 月26 日 (26.06.2006)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願2005-198806 2005 年7 月7 日 (07.07.2005) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): リンテック株式会社 (LINTEC CORPORATION) [JP/JP]; 〒1730001 東京都板橋区本町２３－２３ Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 野中英明 (NONAKA, Hideaki) [JP/JP]; 〒1730001 東京都板橋区本町２３－２３ リンテック株式会社内 Tokyo (JP). 中田 幹 (NAKATA, Kan) [JP/JP]; 〒1730001 東京都板橋区本町２３－２３ リンテック株式会社内 Tokyo (JP). 小林賢治 (KOBAYASHI, Kenji) [JP/JP]; 〒1730001 東京都板橋区本町２３－２３ リンテック株式会社内 Tokyo (JP).

(74) 代理人: 山口義雄 (YAMAGUCHI, Yoshio); 〒2060034 東京都多摩市鶴牧１丁目４番１７号 いずみビル８Ｆ Tokyo (JP).

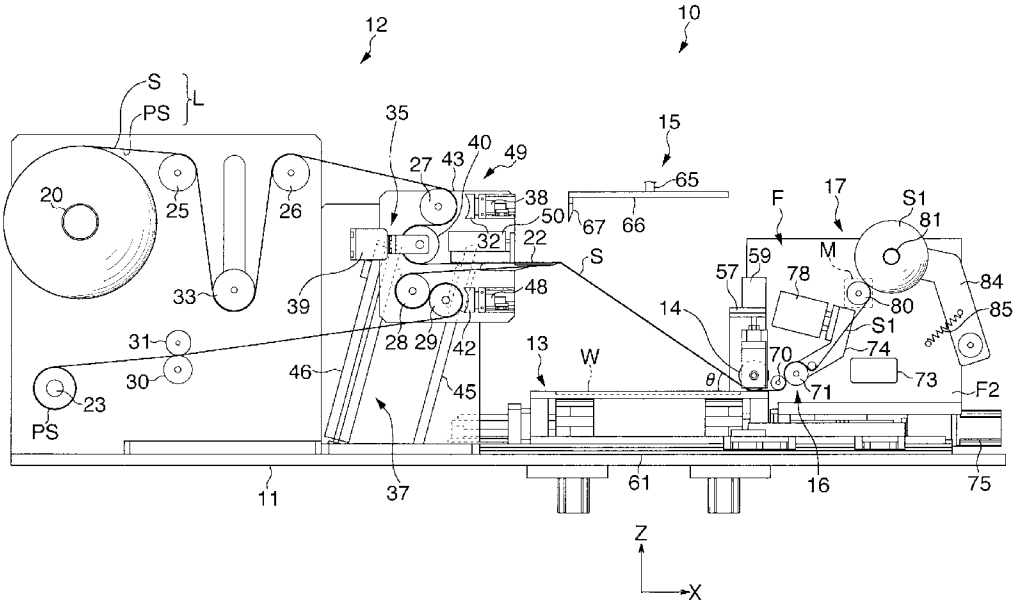
(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE,

[続葉有]

(54) **Title:** SHEET ADHERING APPARATUS AND SHEET ADHERING METHOD

(54) **発明の名称:** シート貼付装置及び貼付方法



(57) **Abstract:** A sheet adhering apparatus (10) is provided with a sheet feeding unit (12) for feeding an adhesive sheet (S) to a position where a plane of a semiconductor wafer (W) faces, and a pressing roller (14) for adhering the adhesive sheet (S) to the wafer (W) by applying a pressing force to the adhesive sheet (S). The sheet feeding unit (12) includes a tension measuring means (35) for measuring tension of the adhesive sheet (S) between a feeding head (49) and the pressing roller (14), and mixing of bubbles between the adhesive sheet (S) and the wafer (W), and wafer warping deformation after sheet adhesion are prevented by maintaining the tension fixed by the tension measuring means (35).

[続葉有]

WO 2007/007531 A1

IS, IT, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— **国際調査報告書**

２文字コード及び他の略語については、定期発行される各*PCT*ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(57) 要約:

半導体ウエハ（W）の面臨む位置に接着シート（Ｓ）を繰り出すシート繰出ユニット（１２）と、接着シート（Ｓ）に押圧力を付与して当該接着シート（Ｓ）をウエハ（W）に貼付する押圧ローラ（１４）とを備えてシート貼付装置（１０）が構成されている。シート繰出ユニット（１２）は、繰出ヘッド（４９）と押圧ローラ（１４）との間の接着シート（Ｓ）の張力を測定する張力測定手段（３５）を含み、この張力測定手段（３５）が前記張力を一定に維持することで、接着シート（Ｓ）とウエハ（W）との間に気泡混入や、シート貼付後のウエハの反り変形が防止されるようになっている。